

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年10月28日

【四半期会計期間】 第53期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

【会社名】 東京エレクトロン株式会社

【英訳名】 Tokyo Electron Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河 合 利 樹

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(5561)7000

【事務連絡者氏名】 経理部長 小 俣 良 二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(5561)7000

【事務連絡者氏名】 経理部長 小 俣 良 二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年8月7日に提出いたしました第53期第1四半期(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

<訂正の経緯及び理由>

当社米国子会社Tokyo Electron America, Inc.(以下「TEA」といいます)におきまして、受注高及び受注残高の集計プログラムに不具合があり、これにより当社が毎四半期に公表してきた連結受注高及び連結受注残高の数値に誤りが生じていたことが判明しました。TEAが当該集計プログラムを導入した平成17年当時から、当社の毎四半期の連結受注高に対して0.4%過少～1.9%過剰の範囲で誤差が生じており、これらの差額が継続して積み上がった結果、平成28年6月末における受注残高は、当社の連結受注残高の2.8%に相当する約104億円が過剰に計上されておりました。

この集計プログラムは、販売系の基幹システムのデータから受注高及び受注残高を集計するためにTEAが独自に開発したものであり、特定の取引事象については、受注データを二重に集計してしまう不具合が生じていました。TEA以外では当該集計プログラムは使用しておらず、他の海外現地法人の受注高及び受注残高に誤りが無いかも調査いたしましたが、TEA以外では問題がないことを確認しました。

今般、プログラム上の不具合の原因究明に至り、その誤ったロジックを修正して訂正後の受注高及び受注残高の算出を行いましたので、訂正するものであります。なお、前述のとおり、平成17年以降に当社が公表してきた連結受注高及び連結受注残高に誤りが認められるものの、有価証券報告書及び四半期報告書の一部訂正に関しましては、有価証券報告書及び四半期報告書の公衆縦覧期間及び修正額の影響度に鑑み、有価証券報告書については過去5年間、四半期報告書については過去3年間の公表分を対象とすることといたします。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第2 事業の状況

3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 生産、受注及び販売の実績

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第2 【事業の状況】

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(4) 生産、受注及び販売の実績

(訂正前)

(省略)

受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
半導体製造装置	156,663	14.1	276,766	31.1
F P D製造装置	11,847	17.0	33,388	13.7
その他	1,835	159.0	201	97.6
合計	170,346	11.9	310,355	24.7

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より、「P V製造装置」事業について重要性が低下したため、同事業を報告セグメントから除外し、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。「その他」の前年同期比については、前年同期の受注高及び受注残高に「P V製造装置」事業の受注実績を含めて算出しております。

(省略)

(訂正後)

(省略)

受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
半導体製造装置	153,465	12.3	266,486	27.3
F P D製造装置	11,847	17.0	33,388	13.7
その他	1,835	159.0	201	97.6
合計	167,148	10.2	300,076	21.4

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より、「P V製造装置」事業について重要性が低下したため、同事業を報告セグメントから除外し、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。「その他」の前年同期比については、前年同期の受注高及び受注残高に「P V製造装置」事業の受注実績を含めて算出しております。

(省略)